

第 37 回宇宙用部品連絡会アジェンダ案

日時： 平成 27 年 4 月 24 日（金） 13：30～16：30

場所： エッサム本社ビル 3 階グリーンホール（神田駅徒歩 3 分）

1. 開会の挨拶
2. JAXA からの情報 (13：30－14：05 35分)
 - 2.1 組織改正による組織名称変更について
 - 2.2 耐放射線性試験の見直しについて（SOI-ASIC SEU 耐性問題からの反映）
3. 部品ユーザからの情報 (14：05－14：25 20分)
4. 部品メーカーからの情報 (14：25－14：55 30分)
 - 4.1 パワーMOSFET の新規認定（状況報告）／富士電機(株)
 - 4.2 ふっ素樹脂/ポリイミド樹脂絶縁電線及びケーブルの認定範囲の変更について／日立金属(株)
- ◆休 憩◆ (14：55－15：15 20分)
5. 部品生産のスケジュールに関するお知らせ (15：15－15：40 25分)
 - 5.1 POL DC/DC コンバータ（状況報告）／日本アビオニクス(株)
 - 5.2 部品標準化とフォーキャストの共有（状況報告）／(株)福井村田製作所
6. QPL/QML 部品認定状況報告 (15：40－15：55 15分)
 - 6.1 共通部品等の認定状況
 - 6.2 QTS/ADS の改定状況
 - 6.3 認定部品の変更管理状況
7. 海外情報 (15：55－16：10 15分)
 - 7.1 インプラントレビューの実施結果報告
8. その他 (16：10－16：30 20分)
 - 8.1 第四回半導体デバイスの放射線照射効果研究会の開催報告／HIREC(株)
 - 8.2 宇宙用部品データベースの改修について
 - 8.3 今年度の予定について
9. 閉会の挨拶